

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2023年12月6日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	华宝基金、莫尼塔、中信建投、国融自营、Point72、安联投资、银华基金、鹏华基金、松熙私募基金、源峰基金、海通资管、安联保险资管、建信保险、天风资管、东吴基金、韩华资产、东方创新投资、浩成资管、嘉合基金、人保资产、上海拓聚投资、慎知资产、守正基金
活动时间	2023年12月6日
活动地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈曦 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司三季度的经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、请问公司目前晶圆代工的成本是什么情况？答：公司结合市场情况与晶圆厂保持及时有效沟通，晶圆代工成本较前期有所下降，对于产品成本的改善会逐步显现出来。2、公司的成本端如何拆分？答：公司产品的成本主要包括晶圆采购、封测服务等，其中晶圆采购成本占比更高。不同的产品的具体成本构成亦有所不同。3、公司针对产品方面有什么规划？答：SLC NAND Flash 产品方面，公司基于 2xnm 制程上持续开发新产品，不断扩充 SLC NAND Flash 产品线，公司先进制程的 1xnm NAND Flash 产品已完成晶圆制造及功能性验证，正在进行晶圆测试及工艺调整。NOR Flash 产品方面，公司各项新产品陆续进入研发设计、晶圆制造、样片验证等阶段。公司将持续完善 NOR Flash 产品线，为客户提供中高容量、高可靠性的 NOR Flash 产品。DRAM 产品方面，公司将不断丰富 DRAM 自</p>

	<p>研产品组合，提高产品市场竞争力。4、能否介绍一下公司的研发团队？答：公司的研发团队在存储芯片领域具有深厚的专业知识背景、丰富的研发工作资历和项目经验，可以胜任从电路设计、版图设计、版图验证、测试等完整的产品设计研发环节。同时，公司通过社招、校招、内推、内部培养等多种方式，持续引入各类人才，不断优化人才结构。5、目前大容量产品都在涨价，公司如何判断明年存储产品价格上涨的弹性？答：近期看到部分大宗存储产品合约价格开始上涨，半导体周期底部信号开始显现。公司存储产品的价格与下游应用的需求相关，预计未来随着下游应用如网络通信、消费类电子等逐渐复苏，公司产品出货量及收入将持续改善。</p>
日期	2023年12月8日